

Webcast

Componentes superficiales y su manejo térmico

Descripción

Hemos observado con el transcurrir del tiempo la evolución de los componentes de montaje superficial, especialmente en aplicadores de potencia más robustos que exigen una mejor administración térmica no solo desde el punto de vista del funcionamiento, también en las técnicas de diseño y ensamblaje. Pensemos en que esta evolución nos ha permitido tener componentes con niveles altos en el montaje de potencia y con la gran ventaja de usarlos dentro de circuitos impresos sin la necesidad de aislarlos o usar conexiones externas a través de cables o conectores, todo desarrollado desde el enfoque IPC tradicional.

Dirigido a

Ingenieros, diseñadores, maestros, investigadores y estudiantes interesados en el uso y conocimiento de las herramientas de diseño avanzadas para el campo de la electrónica.

Objetivo

Desarrollar a través de conceptos físicos y matemáticos, una metodología sencilla que nos permita desarrollar circuitos impresos de potencia con la participación de elementos de montaje superficial con alto manejo de potencia.

Temario

- Breve repaso de conceptos térmicos para el desarrollo de circuitos impresos.
- Desempeño térmico en PCB y dispositivos de potencia.
- Desarrollo de la placa

Instructores

Gerson David Cruz Capador

Experto Técnico Next-Gen, Ingeniero Electrónico, Magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. Amplia experiencia en el desarrollo de soluciones electrónicas, tanto en hardware como en software, con un enfoque particular en sistemas embebidos y comunicaciones. Su experiencia abarca roles clave como Ingeniero de Desarrollo Electrónico, donde ha trabajado en proyectos de alta complejidad técnica, contribuyendo a la creación e implementación de soluciones tecnológicas avanzadas.

Información General

Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Mie. 22 de Ago de 2018

Horarios

10:00 a.m San José de Costa Rica

11:00 a.m CDMX - Bogotá - Quito - Lima

12:00 a.m La Paz - Santiago - Caracas

01:00 p.m Buenos Aires

Herramientas de apoyo



Políticas

Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link <https://www.software-shop.com/formacion/politicas>

Inscríbete ahora